PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-317629

(43) Date of publication of application: 21.11.2000

(51)Int.CI.

B23K 3/02 B23K 1/018 C22C 19/03 C22C 38/00 C22C 38/08

(21)Application number: 11-128154

(71)Applicant : **HAKKO KK**

(22)Date of filing:

10.05.1999

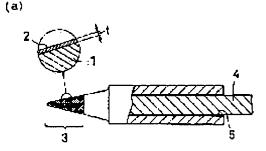
(72)Inventor: KAMIYA KOJI

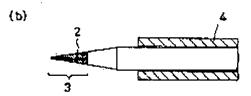
(54) IRON TIP FOR SOLDERING IRON

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an iron tip for soldering iron which can correspond to a lead-free solder and which prevents the oxidation of the iron tip at high temp. and the adhesive wettability of the solder caused by the oxidation.

SOLUTION: An iron-nickel alloy plating is applied to the surface of the copper or the copper alloy-made base body 1 of the iron tip. Then, the hardness of this iron-nickel alloy plating film 2 is \leq about 300 micro Vickers hardness. Further, the layer thickness of the alloy plating layer can be made to e.g. about 50–500 μm . On the other hand, instead of the plating, on the tip part of the copper or copper alloy-made base body, the iron-nickel alloy-made coating member (bulk material) can be used to constitute the iron-tip. Further, the iron-nickel alloy is composed of e.g. about 5–80 wt.% iron. Then, the tip material can be applied not only to the iron tip for soldering iron but also to a nozzle for solder sucking machine.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許山壤公開登号 特開2000-317629

(P2000-317629A)
(43)公開日 平成12年11月21日(2000.11.21)

(51) Int.CL?	l)Int.CL' 統別記号			FI					ラーマコード(参考)			
B23K	3/02			B 2 3	ВK	3/02				M		
										J		
										N		
										P		
										U		
		含拉雅	東東	表菌浆	部求)	質の数7	OL	(全	5	寅)	最終質に続く	
(21)出顯路号		特顯平11−128154		(71)	出顧人	000234	339					
						白光株	式会社					
(22)出題日		平成11年5月10日(1999.5.10)				大阪府	大阪市	浪速区	堪	[草2]	丁目4谷5号	
			1	(72)	形明音	上谷	泰司					
						大阪府	大阪市	被建设	俎	▼2	丁目4番5号	
						白光綠	式会社	₼				

(74)代理人 100085316

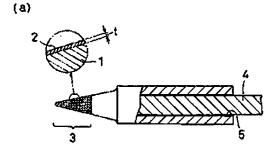
(54)【発明の名称】 辛田ごで用こて先

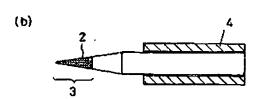
(57)【要約】

(修正有)

【課題】 鉛フリー半田にも対応可能で、こて先の高温 酸化と、それに伴う半田の福れ性の不良を防止する半田 ごて用こて先の提供。

【解決手段】 銅ないし銅合金製の基体の表面に、鉄ーニッケル台金メッキが施されてなるととを特徴とする半田ごて用こて先である。なお、この鉄ーニッケル合金メッキの皮膜硬度は、マイクロビッカース硬度で約300以下である。また、前配合金メッキ層の層厚は、例えば約50~500μmとすることができる。一方、メッキの代わりに、銅ないし銅合金製の基体の先端部に、鉄ーニッケル合金製の被覆部村(バルク村)を設けて構成してもよい。なお、前記鉄ーニッケル合金は、鉄が例えば約5~80重量%とされてなる。ところで、半田ごて用こて先のみならず、半田吸い取り機用のノズルにも適用可能である。





(2)

【特許請求の範囲】

【語求項1】 とて先先端部の表面が、鉄ーニッケル台 金とされてなることを特徴とする半田ごて用こて先。

1

【調求項2】 銅ないし銅合金製の基体の表面に、鉄-ニッケル合金メッキが施されてなることを特徴とする請 求項1に記載の半田ごで用とで先。

【請求項3】 前記鉄ーニッケル合金メッキは、皮膜硬 度がマイクロビッカース硬度で約300以下であること を特徴とする請求項2に記載の半田ごて用こて先。

(f) μmとされてなることを特徴とする請求項2又は請 求項3に記載の半田ごで用こて先。

【請求項5】 銅ないし銅合金製の基体の先端部に、鉄 ニッケル合金製の被覆部村が設けられてなることを特 徴とする請求項1に記載の半田ごて用とて先。

【調求項6】 前記鉄ーニッケル合金は、鉄が約5~8 ①重量%とされてなることを特徴とする請求項1から請 求項5までのいずれかに記載の半田ごて用こて先。

【請求項7】 請求項1から請求項6までのいずれかに 記載の半田ごて用こて先において、このこて先は、半田 20 吸い取り機用のノズルとされてなることを特徴とする半 田吸い取り機用ノズル。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電気半田ごてのこ て先及び半田吸取機用のノズルに関し、特に、鉛フリー 半田にも支障なく使用できる新規な半田ごて用とて先及 び半田吸取機用ノズルに関するものである。

[0002]

情である。

【従来の技術】半田ごてのこて先は、墓鑑側の発熱部の 30 熱エネルギーを先端側の半田付け作業部分に伝える働き をする。このため、こて先に使用される素材(基体)に は、熱伝導性の良い材料が使用されなければならない。 しかも、こて先先繼部の半田付け作業部分は、半田付け 作業がし易いように、半田が濡れる材質である必要があ る。従って、半田ごてのこて先には、熱伝導性が高く、 半田温れ性のよい材料が使用されなければならない。 【りりり3】とのようなことから、こて先には、従来よ り銅(無酸素銅)タフピッチ銅、快削銅、銅台金を含 む) が一般的に使用されている。但し、銅は半田沼れ锉 40 が良い代わりに、半田による摩耗が激しいので、銅にニ ッケルメッキ又は鉄メッキを施されることが多いのが実

【0004】そして、半田ごては、使用される半田に応 じてとて先温度を設定して使用される。通常、最も良い 半田付け温度は、半田の融点+約50°C程度とされてお り、半田ごてのとて先の温度は、作業性を良くするた め、更に約100℃前後高く設定されるのが普通であ る.

が使用され、63%Sn-37%Pbの共晶半田が一般 的に使用されている。なお、この63%5ヵ-37%P り共晶半田の場合、その融点は183°Cである。

【りりり6】しかし、最近になって半田の主要成分であ る鉛(Ph)が公害問題の対象として取り上げられるよ うになり、半田合金のPbフリー化が急速に進められる ようになった。それは家電製品や自動車等の廃棄物が不 法投棄されて、内蔵部品であるプリント基板等から酸性 **南等の外的要因によりPbが溶け出して、地中に浸透**

【諄求項4】 前記合金メッキ層の層厚が、約50~5 10 し、地下水を汚染させることが、とくに米国で大きな社 会問題として取り上げられ、世界中でPbフリーが叫ば れる様になったからである。

> 【0007】この種のPbフリーの半田として、例え は、純錫(Sn)や、錫-銀(Sn-Ag)共晶半田 や、錦-銀-銅(Sn-Ag-Cu)共晶半田等、種々 のものが開発されている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記鉛 フリー半田は、その融点が従来の63%Sn-37%P り半田に比べ高い。例えば、絶Snの融点は約232℃ であり、また。Sn-Ag-Cu系の融点は約210~ 230℃である。このため、Pbフリー半田を使用する 場合には、作業温度を高くする必要があり、350℃以 上に上げないと十分な半田付け性が得られない。ところ が 高温環境下での使用では、こて先が酸化して黒ずみ 易く、濡れ性が悪くなり、半田付けの作業性を悪化させ る問題があった。つまり、とて先の寿命は、通常、銅基 体上のニッケルメッキや鉄メッキが侵食され、基体の銅 まで半田が侵入した時とされるが、こて先作業部が黒く なり、半田が揺れなくなったときも寿命となる。

【0009】また、Pbフリー半田の特徴として、濡れ 性、拡がり性が共晶半田に比べて悪いことが、こて先の 酸化を加速させている。とれば、例えば次のようにし て、起こる。すなわち、作業時にこて先のクリーニング として、こて先をスポンジ等でぬぐうことがあるが、こ の時、こて先の表面から大部分の半田が一緒に除去され ている。そして「共晶半田の場合は「次に半田を送った」 時に、また新しい半田でこて先を覆うことができるが、 Pbフリー半田の場合は、一部分しか半田がまわらない ため、半田の入れ替わりが起こらず、半田で窺われてい ない部分は、やがて下地の鉄メッキ部分が露出して酸化 したり、フラックスが焼け付いて炭化したりするのであ る。通常、こて先の半田メッキ部分は、覆われた半田に よって、熱の伝導を良くしているので、濡れ性がなくな れば、こて先に送られた半田は球状になって著しく作業 性が思くなったり、作業できなくなったりする。

【0010】なお、フラックスは、半田付けを行うとき には、不可欠なものであり、糸半田の場合、ロジン(松 やに)に少畳の活性剤を添加したものが使用されてい

【0005】一方、半田としては、通常、鉧と鉛の合金(50)る。ロジンの主成分であるアビエチン酸は、鴬温では不

http://www4.ipdl.jpo.go.jp/tjcontentdben.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NS... 8/30/2004

活性であるが170°C以上で活性となる。また、フラッ クスの活性範囲の上限は、研究の結果、約350°Cであ ることが分かってきた。つまり、約350℃以上で半田 付けすると、フラックスの効果が減少したり、炭化して こて先に焼き付いてしまうのである。

3

【①①11】一般的に使用されている鎬-鉛の共晶半田 の場合は、前記活性範囲で半田付けすることができる が、融点の高い半田を使ったり、こて先温度を400℃ 以上に設定して作業した場合には、焼付きが起こり易 Pb-Ag-Sn系 (融点約309°C) の高温半田や、 前記鉛レス半田では、焼き付きが起こり易い。

【①①12】このように、鉛レス半田では、従来の錫-鉛共晶半田に比べて、半田温れ性や拡がり性が悪く、銅 製量体の表面に鉄メッキを縮した従来の半田ごてでは、 鉛フリー半田には対応できず、数回の半田付け作業しか できなかった。

【りり13】この発明は、上記事情に鑑みてなされたも のであり、その主たる目的は、半田とて先が約350℃ 以上の作業環境においても、ヤニ入り半田合金(特にフ=20=【0020】とのように、一般的には、半田添れ性と半 ラックス) の劣化による温れ性及び拡がり性の悪化を抑 制すると共に、純銅ないし銅合金製のこて先の高温酸化 をも抑制して、比較的長期間に渡って良好な半田付け作 **紮を可能とする半田ごて用こて先を提供することにあ** る。そして、とれにより、Pbフリー半田にも十分対応 可能な半田ごて用こて先を提供することを目的とする。 [0014]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明の半田ごで用とて先は、とて先先繼部の衰面 が、鉄ーニッケル合金とされてなることを特徴とする。 具体的には、例えば、銅ないし銅合金製の基体の表面 に、鉄ーニッケル台金メッキが施されてなることを特徴 とする半田ごて用こて先である。なお、この鉄ーニッケ ル合金メッキの皮膜硬度は、マイクロビッカース硬度で 約300以下である。また、前記合金メッキ圏の層厚 は、例えば約50~500μmとすることができる。-方、メッキの代わりに、銅ないし銅合金製の基体の先端 部に、鉄ーニッケル合金製の被覆部村(バルク村)を設 けて構成してもよい。なお、前記鉄ーニッケル合金は、 鉄が例えば約5~80重量%とされてなる。ところで、 本発明は、半田ごて用こて先のみならず、半田吸い取り 機用のノズルにも適用可能である。

[0015]

【発明の真施の形態】この発明の半田ごて用こて先は、 こて先先進部の表面が、鉄ーニッケル合金とされてな る。鉄ーニッケル台金とした理由は、以下のとおりであ る.

【①①16】図3は、各金蹊が半田に侵食される量を測 定したグラフである。具体的には、一定置の糸半田をこ は一般的に使用されるこで先温度帯とし、こで先温度の 変化による侵食量の測定結果を示している。

【①①17】この図より明らかなとおり、いずれの金店 においても、こて先温度が高くなる程、侵食量が多くな り、また半田の温れ性が良い材料程、侵食量が多くなる ことが分かる。

【0018】半田の濡れ性は、その金属の結晶構造、表 面状態(酸化皮漿の出来易さ)、金属の純度、金属の硬 度等。種々の要因から決まってくるが、一番大きな要因 い。よって、Sn-Sh系(融点235~240℃)や 10 は半田の鉧との金属間化合物の出来易さによるものと考 えられる。

> 【①019】鉄の場合、その金属間化合物は、低温域で はFeSn。であるが、約400℃以上の高温域になると、 FeSnに変化し始め、特に450 C以上になると、その変 化が顕著になる。この現象は、図3からも読み取れる。 鉄の侵食置は、とて先温度が400℃を越えると増加し 始め、450℃を境に急激に増加している。また、銅や 金等は、侵食量が鉄・ニッケルに比べ、100倍近くあ り、侵食というより、溶解ということができる。

> 田耐侵食性は、相反する関係にある。ところが、鉄ーニ ッケル合金 (図示例では鉄5.8%合金) の場合、耐侵食 性(侵食量)は鉄とほぼ同じであるのに、半田温れ性は 鉄よりも良いという興味深い結果が得られた。錦との金 層間化合物の生成過程で、純金層にはない現象が起こっ ていることに超因するものと思われる。

【0021】なお、銅基体にニッケルメッキしたこで先 は、半田濡れ性が改善されるが、鉄メッキしたこて先と 比べて、侵食量が約20倍となるので、寿命が約1/2 30 ()となってしまう。

【0022】このようなことから、本発明では、銅基体 に鉄ーニッケル合金部分を設けたこて先を開発するに至 ったものである。

[0023]

【実施例】以下、本発明の半田ごで用こで先について、 **更に詳細に説明する。図1は、本発明の半田ごて用こて** 先の一実施例の概略構造を示す断面図である。

【①024】との発明のとて先は、銅ないし銅合金を基 体1としており、少なくとも先端側の半田付け作業部分 40 3に、半田濡れ性の良い鉄ーニッケルメッキの皮膜2が 設けられている。

【10025】との実施例のとて先は、基端側が熔状に形 成される一方。先端側は、先端側に行くに従って先細と なる略円錐形状に形成されている。そして、このこて先 は、発熱体4によって加熱されて使用される。つまり、 こて先先繼部の半田付け作業部分3は、こて先の基準側 に設けられた発熱体4からの熱を熱圧導によって伝えれ て加熱される。なお、発熱体4としては、例えばセラミ ックヒーターが使用される。

て先に送ったときのこて先の侵食費を示しており、機輔 50 【0026】ところで、発熱体4は、こて先の内部に設

けることもできるし、こて先の外国部に配置してもよい。つまり、図1(a)に示すように、こて先基端部に基端面に関口して発熱体差込穴5を形成し、その差込穴5に、こて先の基端部から発熱体4を差し込んで、こて先を内側から加熱する構成としてもよい。或いは同図(b)に示すように、こて先の基準側の外国部に発熱体

(b) に示すように、こて先の基準側の外周部に発熱体 4を配置して、こて先を外側から加熱する構成としても よい。

【10027】鉄-ニッケルメッキは、こて先の外層部全体に縮してもよいが、こて先先端部の半田付け作業部分 10 3だけに施してもよい。なお、通常、半田付け作業部分 3以外の箇所には、半田福れ性のない表面処理、例えばクロムメッキを縮している。

【0028】鉄-ニッケル合金皮膜2は、マイクロビッカース硬度日v=300以下の軟わかいもので、展延性がよく、表面酸化膜の除去が比較的容易である。この皮膜は、硫酸第一鉄(200~300g/1)をベースにした光沢剤等の有機化合物をほとんど使用しないメッキ浴で得られる。

【0029】なお、鉄ーニッケル合金の組成割合も、適宜に設定されるが、例えば、鉄が約5~80重量%、好ましくは約10~80重量%、更に好ましくは10~60重量%程度とされる。

【0.030】また、鉄ーニッケル合金メッキ圏2.0圏厚 tは、特に関わないが、余りに厚くすると、熱任導性が 悪くなることを考慮して、例えば約 $1\sim1000\,\mu\mathrm{m}$ 、 好ましくは約 $5.0\sim500\,\mu\mathrm{m}$ 、夏に好ましくは約1.0 $0\sim500\,\mu\mathrm{m}$ 程度に設定される。

【0.031】なお、メッキは、通常、温式で行われるが、厚さ約数A~数 μ m程度のイオンプレーティングや、厚さ約 1μ m~1 m m程度の溶射等の乾式でメッキすることも可能である。

【① 032】ととろで、とて先先繼部に鉄ーニッケルメッキを施すことによらず、とて先先端部に、鉄ーニッケル合金製の被覆部材6をロウ付け又は圧接等によって一体的に固着してもよい。例えば、図2(a)に示すように、とて先先端部を傾斜面に形成し、その傾斜面に沿って鉄ーニッケル合金のバルク材61をロウ付け又は圧接

してもよい。また、同図(b)に示すように、とて先先 蟾郎を段付きの略円錐台形状とし、その先蟾部に略三角 錐形状のバルク村62をキャップ状にロウ付け又は圧接 して取り付ける等してもよい。

[0033]上記各実施例では、この発明を半田ごてのこて先に適用した例について説明したが、本発明は、半田吸い取り機用のノズルにも適用可能である。すなわち、半田吸取機の吸取ノズルの先端部の表面に、鉄ーニッケル合金メッキを施したり、或いは鉄ーニッケル合金製のバルク材をロウ付け又は圧接して取り付けて構成する。そして、そのノズルをヒーターで加熱しつつ、ノズル先端を除去すべき半田に当てて溶融させ、溶融半田を真空ポンプで吸引するのである。鉄ーニッケル合金メッキを経すことで、Pbフリーの半田の吸い取り除去に好適に使用することができる。

[0034]

順は、硫酸第一鉄(200~300g/!)をベースに 【発明の効果】以上詳述したとおり、この発明の半田ご した光沢剤等の有機化合物をほとんど使用しないメッキ で用こて先によれば、350℃以上の比較的高い作業温 度でも、良好な半田付けを比較的長期間に渡って実現可 【0029】なお、鉄ーニッケル合金の組成割合も、適 20 能である。よって、比較的融点が高い鉛フリー半田にも 宜に設定されるが、例えば、鉄が約5~80重量%、好 十分対応可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の半田ごて用こて先の一実施例を示す図 である。

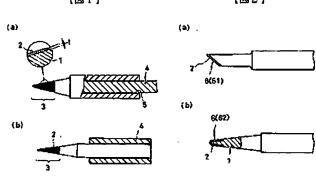
【図2】本発明の半田ごで用こて先の他の実施例を示す 図である。

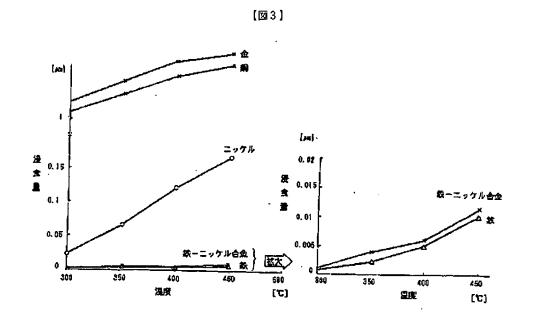
【図3】各金属が半田に侵食される量を測定したグラフ である。

【符号の説明】

- 30 1 墓体
 - 2 鉄ーニッケル合金部分(鉄ーニッケル合金皮膜等)
 - 3 半田付け作業部分
 - 4 発熱体
 - 5 発熱体差込穴
 - 6 鉄ーニッケル合金材
 - 61 バルク村(被覆部村)
 - 62 バルク村(被礙部村)

(5) 特開2000-317629 【図1】 【図2】





フロントページの続き (51) Int.Cl.' 識別記号 Fi ラーマコード(参考) B 2 3 K 1/018 B23K 1/018 C22C 19/03 C22C 19/03 G 302 302X 38/00 38/00 38/08 38/08